证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2023-072

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于公司布局三大领域光刻胶相关产品收到 多项重大项目立项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“公司”）及下属子公司于今年相继收到多项光刻胶相关国家及省级重要项目立项通知，公司布局的三大领域光刻胶相关产品：集成电路晶圆光刻胶及核心原料、半导体先进封装用光刻胶、半导体柔性显示用光刻胶，均为制约我国半导体产业发展的“卡脖子”材料之一，公司及下属子公司作为项目牵头单位负责研究开发出具有自主知识产权的三大类光刻胶及上游关键核心原料，满足我国半导体行业的产业链自主可控需求。上述相关项目将获得项目经费支持合计不超过16,393.38万元。具体情况如下：

一、项目经费支持情况

项目	获得经费的主体	提供经费的主体	获得经费的原因或项目	项目补助形式	项目总获批金额	公司获分配金额	项目补助依据	是否与公司日常经营活动相关	是否具有持续性
1	湖北鼎龙控股股份有限公司及相关下属子公司	***	浸没式氟化氩（ArFi）光刻胶上游光酸项目	现金	不超过6,000万元	不超过4,200万元	***	是	否
2		***	先进封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）技术研发和产业化项目	现金	不超过4,661万元	不超过4,661万元			
3		***	显示面板用光敏聚酰亚胺（PSPI）项目	现金	不超过5,000万元	不超过2,800万元			
4		***	***	现金	***	不超过2,250万元			
5		***	光刻胶等半导体制造工艺材料开发与应用	现金	不超过4,580万元	不超过2,482.38万元			

合计	不超过 16,393.38 万元	--
----	------------------------	----

注：1、上表内标“***”处为涉密信息，豁免披露，其中项目4不另作具体披露。

2、截至本公告披露日，公司及下属子公司尚未收到项目1-4相关的项目资金；项目5已收到496.476万元补贴款项，剩余为已确认但尚未收到款项。上述金额系公司及下属子公司预计获得的金额，具体金额以实际拨付为准。

二、立项项目的基本情况

（一）项目一

公司作为项目牵头单位，与其他4家单位组成联合体，共同实施“浸没式氟化氩（ArFi）光刻胶上游光酸项目”。该项目总投资概算22,000万元，项目将获得不超过6,000万元国家项目资金支持，其中公司及下属子公司预计可分配金额不超过4,200万元。

（二）项目二

公司下属子公司实施“先进封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）技术研发和产业化项目”。该项目总投资概算23,306万元，公司下属子公司将获得不超过4,661万元国家项目资金支持。

（三）项目三

公司控股子公司作为项目牵头单位，与其他4家单位组成联合体，共同实施“显示面板用光敏聚酰亚胺（PSPI）项目”。该项目总投资概算18,000万元，项目将获得不超过5,000万元国家项目资金支持，其中公司及下属子公司预计可分配金额不超过2,800万元。

（四）项目四

公司与其他单位组成联合体，共同实施国家某光刻胶类重要项目，公司将获得不超过2,250万元项目资金支持。本项目为涉密信息，不另作更多具体披露。

（五）项目五

公司作为项目牵头单位，同时承担其中“柔性显示PSPI光刻胶的研究及量产技术”、“芯片制造用KrF光刻胶的开发与应用”、“芯片制造用ArF光刻胶的研究”共三项与光刻胶相关课题。该项目总投资概算15,317.20万元，项目将获得不超过4,580万元省级项目资金支持，其中公司及下属子公司涉及光刻胶相关项目预计可分配金额不超过2,482.38万元。

三、补助的类型及对公司的影响

（一）补助的类型

公司及下属子公司拟将获得的合计不超过16,393.38万元项目经费支持，均为与资产相关的政府补助，按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，将计入递延收益，分摊转入各年损益。具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

（二）对公司的影响

1、通过实施项目一，研究开发出具有完全自主知识产权的浸没式氟化氩（ArFi）用光酸制备核心关键技术，实现ArFi光刻胶用光酸进口替代。解决高端光刻胶“卡脖子”原材料的问题，实现我国高端光刻胶产业链自主可控及供应链安全，提升我国晶圆光刻胶关键核心技术自主创新水平，促进我国集成电路产业发展和技术进步。

2、通过实施项目二，解决先进封装用PSPI材料合成技术、材料纯化技术、材料成膜及验证评价技术等多个行业难题，形成完全具备自主知识产权的先进封装用PSPI材料及关键单体的制备技术，开发出具有自主知识产权的先进封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）材料，完成在国内先进封装企业应用验证并成功导入，有效填补国内市场空白，打破国外垄断，助力我国先进封装产业发展。

3、通过实施项目三，开发出半导体柔性显示用光刻胶的结构设计、合成工艺、纯化处理、应用评价以及主要原材料制备等关键技术，制备出具有自主知识产权的半导体柔性显示用光刻胶，打破国外垄断，加速我国柔性显示面板材料产业国产化，提升我国新型显示产业市场竞争力。

4、通过实施项目五，开发及量产出具有自主知识产权的半导体柔性显示用光刻胶、KrF/ArF光刻胶等材料，解决国内芯片、面板等制造领域“卡脖子”材料问题，实现关键材料国产化，保障产业链发展安全。

上述光刻胶产品相关项目的立项，是公司作为创新类材料平台型公司综合实力的重要体现，有利于公司实现半导体材料产品多元化发展，扩大公司在半导体行业的影响力及市场占有率。

四、风险提示

截至本公告日，上述项目经费支持中公司尚未实际收到的金额为不超过15,896.904万元，补助资金的到账时间具有一定的不确定性，公司将会根据有关

要求披露上述补助的后续进展情况。公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理，有关本次补贴的具体会计处理及最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2023年11月10日